



日本アトマイズ加工
福井 秀明氏

「電子部品向けの微粉はまだ大きく伸びる余地がある」。日本精鉱グループの金属粉末メーカー、日本アトマイズ加工の社長に就任して約2カ月が経過、業績拡大の原動力になっ

た積層セラミックコンデンサー(MLCC)の導電ペースト向け微粉に期待を込める。水アトマイズ法として

電子部品向け微粉に期待

て世界で初めて粒径10μmの銅と銀の微粉を開発したのは2002年。その後4年間、微粉はかなりの勢いで伸びてきた。06年度も需量の拡大傾向は続き、生産量は昨年の400トンから約500トンに増えている。ただ内部電

極にはニッケルが使われているため、内部電極向けの銅微粉を研究開発している。銀微粉もMLCC用途だが、市場が急拡大しているプラスマティスプレー(PDP)への参入をめざす。新たな市場開拓のため提案型営業も強化している。その第一弾製品として世界で初めて水アトマイズ法による白金の微粉を開発。現在は自動車のガ

スセンサー向けにサンプル出荷を行っている。今後の事業展開について「やはり技術開発が中心」と話す。そのため、新製品開発のために7月1日に技術開発室を新設し、「ここに精鋭を集めて当社の」。(増田 正則)

▽福井秀明(ふくい ひであき)氏 1970年阪大工学、双日(旧日商岩井)入社。00年アルコニックス(旧日商岩井アルコニックス)取締役新素材電子材料

事業部長。02年インコ(ひであき)氏 1997年同社ニッケル営業第一部長。06年日本精鉱入社。趣味はゴルフ。47年2月7日生まれ、香川県出身。